

证券代码：002579

证券简称：中京电子

惠州中京电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（机构调研）
参与单位名称及人员姓名	光大证券、华能贵诚信托、深圳华润元大资管、深圳旦恩资本、深圳君如基金、前海泽源基金、珠海聚隆资本等机构投资者共 11 人。
时间	2021 年 2 月 3 日 14: 00 至 17: 00。
地点	惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号中京电子公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总裁兼董事会秘书余祥斌；证券与投资中心副总经理陈汝平；证券事务代表黄若蕾。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>董事会秘书代表公司，在公司对外披露信息范围内对公司基本状况进行了介绍，包括公司简介、发展历程、制造基地、主营业务产品、业务模块、主要客户、财务及业绩情况、未来发展规划等。</p> <p>二、投资者交流问答</p> <p>董事会秘书：感谢与欢迎各位来访本公司，以加深对公司的了解及增进与投资者互动。投资者来访本公司须遵循深圳交易所及监管部门有关规则，不打探公司未披露事项，包括但不限于：公司未来的重大重组、增发、利润分配、转增股份、重大投资、未来业绩等股价敏感内容。请将提问交流内容限于已经披露的信息。</p> <p>问 1：请问如何看待目前行业发展趋势？</p>

答:

(1) PCB 市场持续稳步增长, 高端产品国产替代进程加速

受益于全球 PCB 产能向中国持续转移以及国内电子信息产业的蓬勃发展, PCB 行业国内增速显著高于全球增速, 而行业中优质与规模企业保持了更高的增长速度。同时, 由于国内 PCB 行业起步较晚, 高端 PCB 产品 (HDI、R-F、SLP、IC 载板等) 的产能不足、技术储备不够, 仍较多依赖于向中国台湾、日本、韩国及欧美等地进口, 国内高端 PCB 产能不足的现状与国内下游蓬勃发展的新兴电子产品的需求相矛盾, 国产替代进程有望加速推进。

(2) 行业整合趋势延续, 优质企业有望获得快速发展机遇

国内 PCB 行业目前集中度整体较低。近年来, 受国家环保政策日益趋严、高端产品项目投资强度大幅增加、中低端产品市场竞争加剧等因素影响, PCB 行业整合趋势加快。其中环保治理不规范、未能持续进行产业升级投资的中小企业或面临较大发展压力, 而先进企业通过借助客户、技术、质量、成本及规模等优势, 能积极响应下游新兴市场需求变化, 不断提升产品与技术创新, 加快扩大生产规模。

通过行业整合和技术升级, 国内 PCB 行业中的优质企业有望获得快速发展的历史机遇, 尤其是 PCB 行业中的上市公司, 有望通过内生及外延方式实现跨越式发展。

(3) 5G 通信等新技术与新兴应用领域的蓬勃发展催生 PCB 巨大市场需求

PCB 产业发展受下游电子信息产业应用市场需求变化的深刻影响。近年来, 随着 5G 通信、新型显示、新能源汽车、无人驾驶、人工智能、工业互联网以及数据中心与云计算等高附加值、高成长性新兴应用领域的迅速发展, PCB 产业获得了更广阔的市场空间。

(4) 电子产品的集成化、小型化、智能化对 PCB 提出了新的工艺技术要求

近年来, 在 5G 通信与集成电路代际更迭、数据流量与数据存储爆发式增长的背景下, 将带动相关电子终端产品朝着超高速、高度集成、

轻薄化、智能化方向发展，从而促进 PCB 产品向高精度、高密度、高速高频、轻薄化等方向发展，高速高多层 PCB（HLC）、高阶高密度互联板（HDI & AnyLayer HDI）以及对三维封装及空间节省要求较高的刚柔结合板（R-F）、类载板（SLP）和 IC 载板等工艺产品的需求将大幅提升。

问 2：请问中京电子优势有哪些，如何在竞争中突出？

答：

(1) HDI 产品技术优势

公司是内资企业中较早进行 HDI 投资生产的企业，自 2014 年即开始大规模投产 HDI，技术积累深厚，生产经验丰富，目前公司 HDI 产品主要以 2 阶以上为主，已批量生产 3 阶以上 HDI (含 AnyLayer)。自 2019 年以来，公司 HDI 产品长期供不应求，其中 HDI 产品在小间距 LED/MiniLED、消费电子等应用领域有较高市占率。2021 年一季度末公司珠海富山新工厂将开始投产，产品以 3 阶、4 阶 HDI (含 AnyLayer) 及以上为主。新工厂投产后原有产能不足问题得以解决，将进一步扩大公司 HDI 产品优势。

(2) FPC 产品技术优势

公司子公司元盛电子是国内最早专业从事 FPC 生产的内资龙头企业之一，在 OLED 显示、智能终端、生物识别、动力电池管理等细分市场领域具有较明显市场竞争优势。

在 OLED 显示领域，元盛电子 FPC 产品重点配套京东方、深天马、TCL 华星光电等客户用于智能手机、PAD、NoteBook 等领域；

在智能终端领域，元盛系任天堂 FPC 主要供应商之一；在生物识别领域，重点配套丘钛科技、紫文星等客户；

在动力电池管理（BMS）领域，重点配套比亚迪、上汽集团等客户，2021 年以来，BMS 出货增速明显，有望培育成公司新的优势产品。

(3) 管理效率及人才优势

近年来，公司确立“致力于成为全球领先的电子信息产品与服务商”的发展愿景，秉承“改革、创新、高效”的企业文化，将高效落实到企

	<p>业经营决策与执行层面。</p> <p>公司在珠海富山投资新建的 PCB 新工厂，从投建到近 13 万平方米的主体厂房封顶，仅历时 8 个月，预计到投产历时 14 个月；在成都高新区新投资的“新型显示（OLED-FPCA）”项目从投资决策到产品试产仅用 3 个月，快速响应了大客户产品需求。同时，近年来公司持续引进行业一流技术人才及管理团队，整体技术水平及运营效率不断提升。公司通过持续创新和高效执行打开企业发展新阶段。</p> <p>问 3: 请问原材料上涨是否对公司有影响?</p> <p>答:</p> <p>原材料上涨其实也体现了 PCB 行业处在景气度上升期。公司建立了完善的采购管理制度及供应商管理制度，与主要供应商建立了良好的供应合作关系，签署了相关供货保障协议。通过严格比价议价、集中批量采购、策略性备料、长期跟踪金属类、化工类等产品的价格变动趋势进行预防采购等方式降低采购成本，原材料价格风险相对可控。另外，公司产品在细分市场具备较强的竞争优势和客户认可度，产品单价会随原材料上涨进行调整，部分成本可实现向下游转移。</p> <p>三、参观工厂</p> <p>四、本次接待没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 2 月 3 日